



Hauptversammlung 2024

Burkhardt Frick, CEO

Haftungsausschluss

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der SÜSS MicroTec SE oder ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen daher Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der SÜSS MicroTec SE liegen. Die SÜSS MicroTec SE übernimmt deshalb keine Gewähr dafür, dass die Erwartungen und Ziele, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, erreicht werden. Die SÜSS MicroTec SE beabsichtigt auch nicht und übernimmt keine Verpflichtung, eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

01

Unternehmen im Überblick

02

Entwicklung im Geschäftsjahr 2023

03

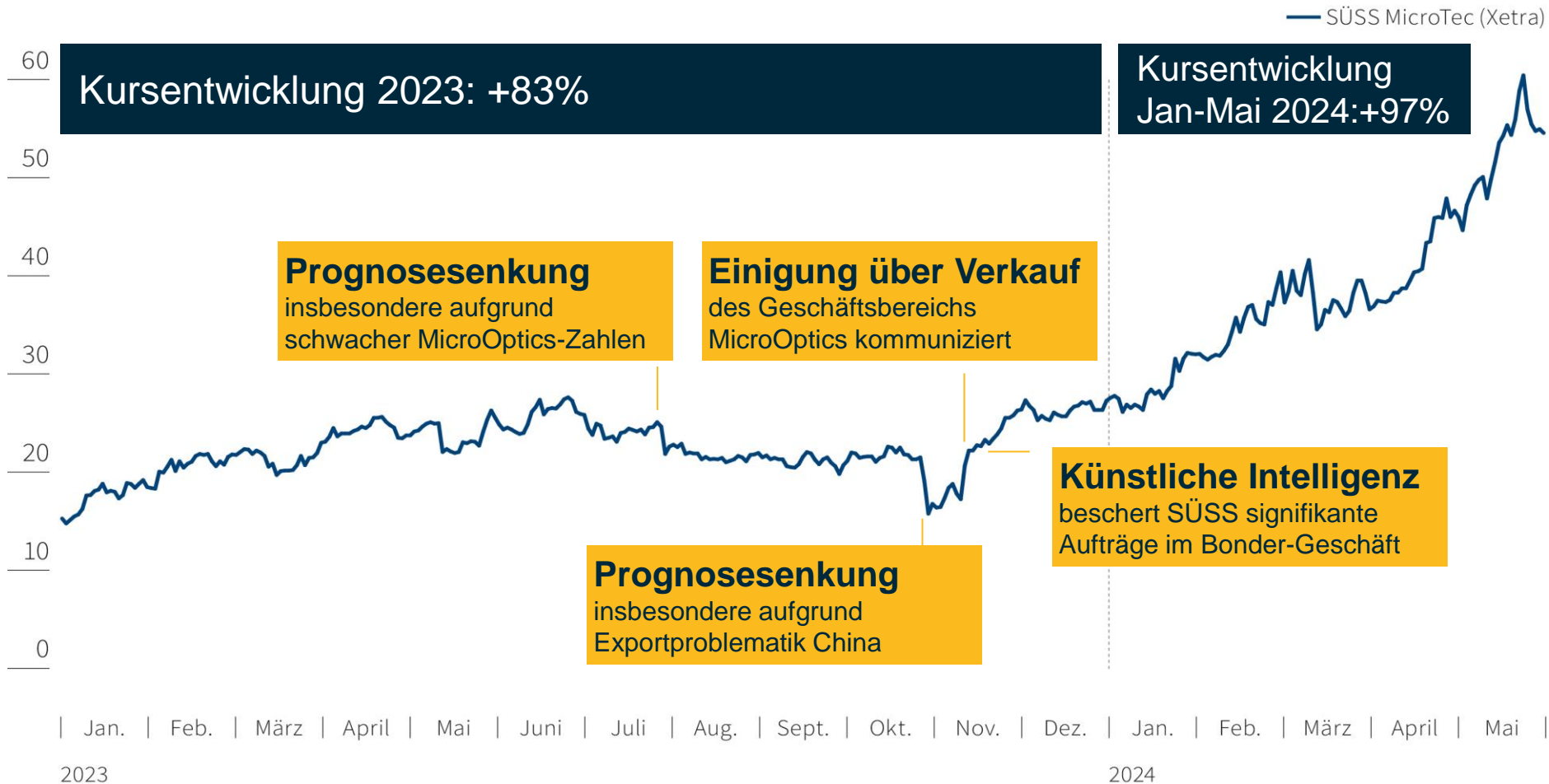
Ausblick 2024 und Entwicklung Q1-2024

04

Strategie und Ambitionen 2030

SÜSS MicroTec-Aktie als Spiegelbild des Geschäftsjahres 2023

Entwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum vom 03.01.2023–31.05.2024 (in €)





CFO

Dr. Cornelia Ballwießer

- Finanzen und Controlling
- Recht und Compliance
- Interne Revision
- Investor Relations
- IT
- ESG



CEO

Burkhardt Frick

- Vertrieb und Service
- Strategie
- HR
- Business Units:
Advanced Backend Solutions,
Photomask Solutions



COO

Dr. Thomas Rohe

- R&D
- Einkauf
- Produktion
- Logistik
- Qualitätsmanagement
- Produkt-Center
- Facility Management

Durch Veräußerung von MicroOptics: Voller Fokus auf die Halbleiterindustrie

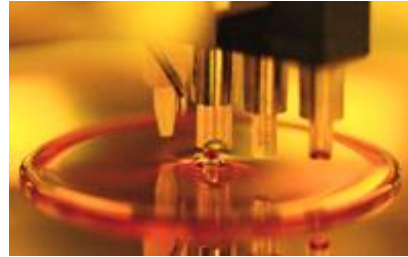
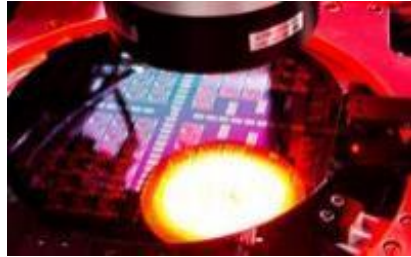
Frontend

Segmente Photomask Solutions



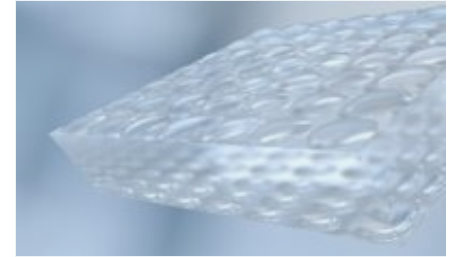
Advanced Backend

Advanced Backend Solutions



Komponenten¹

MicroOptics



Produkte

Fotomasken-Equipment



MaskTrack X

Imaging

Mask Aligner
MA200/300



Projection
Scanner
DSC300

Coating



ACS300

Bonding

XBC300



XB8

Mikrolinsen



Mikrolinsen

1) Der Verkauf des MicroOptics-Geschäfts wurde im Januar 2024 abgeschlossen.

Durch Veräußerung von MicroOptics: Voller Fokus auf die Halbleiterindustrie

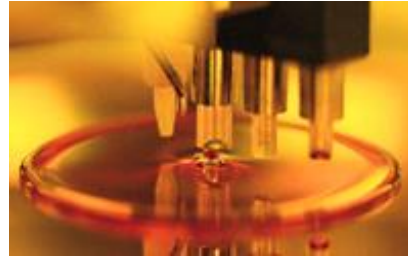
Frontend

Segmente Photomask Solutions



Advanced Backend

Advanced Backend Solutions



Produkte

Fotomasken-Equipment



MaskTrack X

Imaging

Mask Aligner
MA200/300



Projection
Scanner
DSC300

Coating



ACS300

Bonding

XBC300



XB8

01

Unternehmen im Überblick

02

Entwicklung im Geschäftsjahr 2023

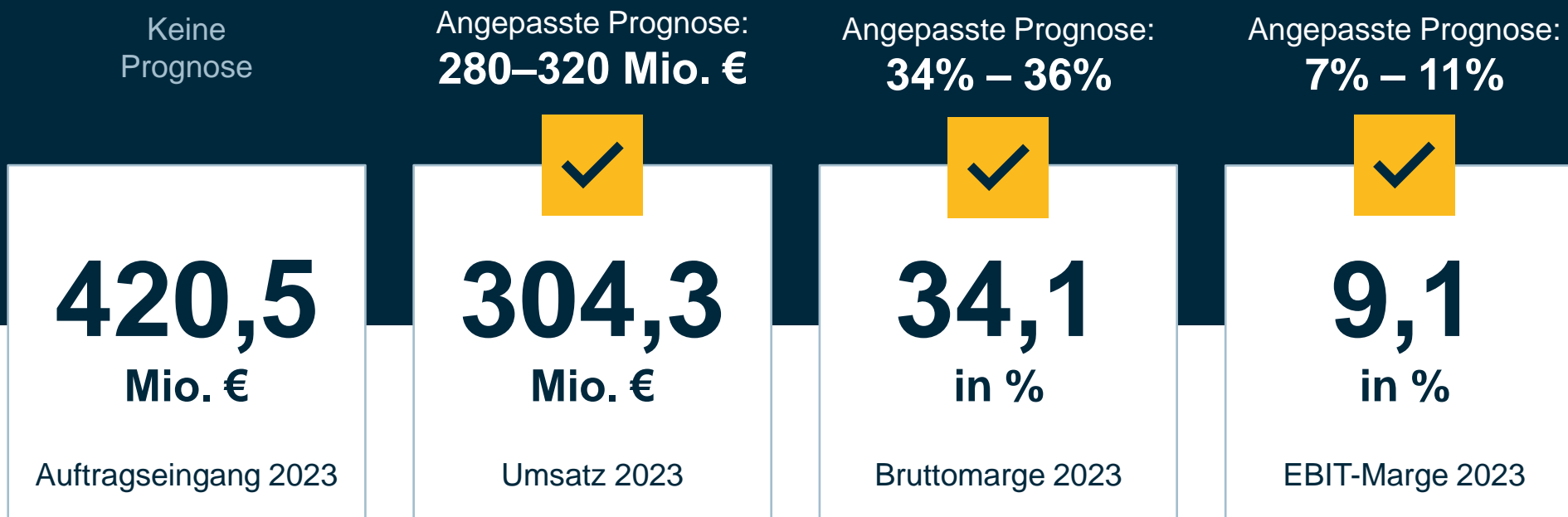
03

Ausblick 2024 und Entwicklung Q1-2024

04

Strategie und Ambitionen 2030

Finanzergebnisse 2023 (ohne den veräußerten Geschäftsbereich MicroOptics)



Eckpunkte des Geschäftsjahres 2023



- Erneutes Rekordjahr Jahr in Bezug auf Auftragseingang und Umsatz
 - Brutto- und EBIT-Marge waren u.a. durch einen unvorteilhaften Produktmix und Kosten für den Kapazitätsausbau in Taiwan sowie diverse Outsourcing-Projekte belastet
-
- Verkauf des Geschäftsbereichs MicroOptics, Transaktion wurde im Januar 2024 erfolgreich abgeschlossen
 - **SÜSS ist nun ein voll fokussierter Hersteller von Halbleiter-Equipment**
 - Kapazitätsausbau zur Fertigung von temporären Bondern in Taiwan
 - **schafft Raum für zusätzliche Fertigungskapazitäten für andere Produktbereiche am (aktuell voll ausgelasteten) Standort in Sternenfels**
 - Verschiedene Projekte zur Einbindung externer Produktionspartner wurden gestartet
 - **schaffen zukünftig weitere Fertigungskapazitäten und Flexibilität für geplantes Wachstum**

Erwähnenswertes aus den Segmenten 2023



Hohe Nachfrage in allen Segmenten

Advanced Backend Solutions:

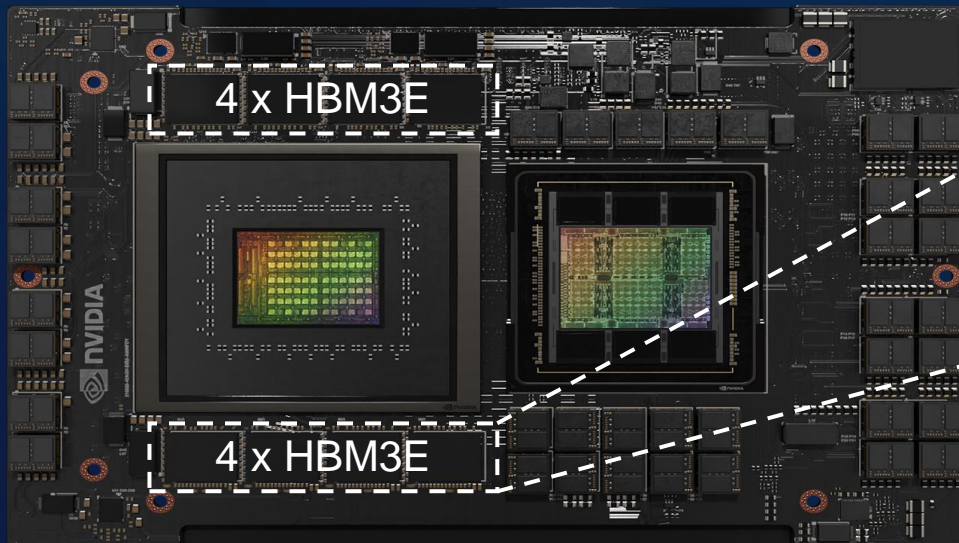
- Hervorragender Auftragseingang für temporäre Bonder im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz
 - Nahezu stabiles Geschäft mit Mask-Alignern
 - Auftragseingang und Umsatz mit Coatern im Einklang mit dem gesamten Halbleitermarkt eher schwach
 - Entwicklungspartnerschaft mit Heraeus sorgt für zusätzliches Potenzial in unserem Inkjet-Geschäft
-

Photomask Solutions:

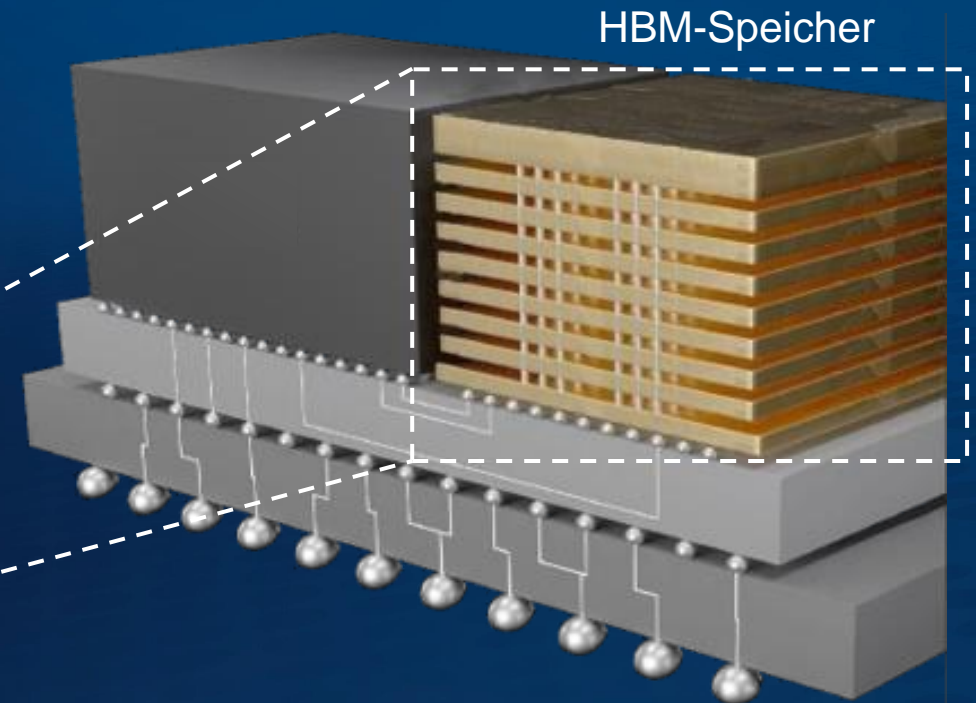
- Weiterhin hoher Auftragseingang in Asien (vor allem China)
- Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr um fast 84%

Künstliche Intelligenz macht neue Hochleistungshalbleiter nötig

Ein wichtiger Teil von KI-Chips sind Hochleistungs-Speicherchips (kurz: HBM = high-bandwidth memory). Für eine schnelle Datenübertragung und hohe Kapazität werden Speicherchips zu einem Würfel gestapelt.

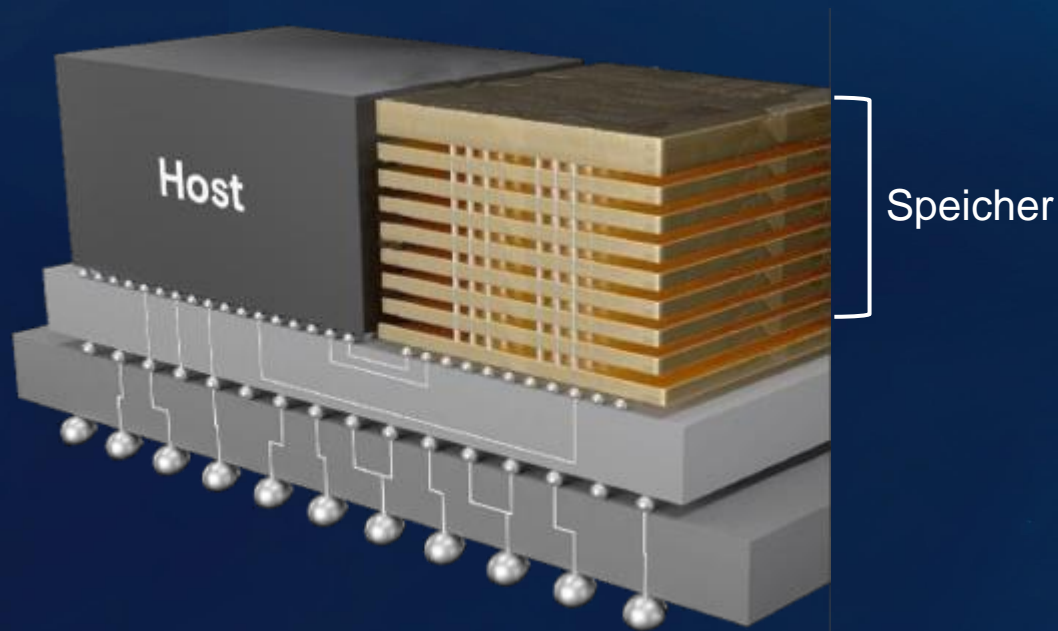


Quelle: nVIDIA, GH200 Superchip



Quelle: Micron, HBM3E

Gestapelte Speicherchips und neueste Advanced Packaging-Technologien sind die Basis für Hochleistungs-KI-Chips.



Quelle: Micron, HBM3E

Der Beitrag von SÜSS zur Herstellung von KI-Chips

1. Anwendungsfeld:

Temporäre Bonder und Debonder zum Dünnen von HBM-Speicherchip-Wafern

2. Anwendungsfeld:

Temporäre Bonder und Debonder zum Dünnen des Silizium-Interposers

3. Anwendungsfeld:

Chemische Reinigung nach dem Debonding in den Anwendungsfeldern 1 und 2

4. Anwendungsfeld:

UV-Projektionsscanner für die Strukturierung des Silizium-Interposers

Rekordergebnisse für Auftragseingang und Umsatz, Ergebnismargen müssen verbessert werden

in Mio. €	2023*	2022*	Veränderung
Auftragseingang	420,5	411,0	2,3%
Auftragsbestand zum 31.12.	452,5	335,4	34,9%
Umsatz	304,3	260,0	17,0%
Bruttoergebnis vom Umsatz	103,9	100,6	3,2%
Bruttomarge	34,1%	38,7%	-4,6%-Pkt.
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	27,8	31,5	-11,7%
EBIT-Marge	9,1%	12,1%	-3,0%-Pkt.

- **Rekordauftragseingang und sehr hoher Auftragsbestand** bilden solide Grundlage für weiteres Wachstum
- **Rückläufige Bruttomarge**, hauptsächlich durch einen ungünstigen Produktmix, Transformationskosten aufgrund der Einbindung externer Produktionspartner und Anlaufkosten für die Sonderfertigung in Taiwan
- **Absolutes EBIT und EBIT-Marge** unter Vorjahr, was auf höhere F&E- und Verwaltungskosten zurückzuführen war

*ohne den veräußerten Geschäftsbereich MicroOptics

Ergebnis aus nicht-fortgeführten Aktivitäten belastet Jahresüberschuss und Nettoliquidität

in Mio. €	2023	2022	Veränderung
Ergebnis aus nicht-fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern)	-12,6	1,3	-
Jahresüberschuss	4,7	24,5	-80,8%
Ergebnis je Aktie (in €)	0,25	1,28	-80,5%
Nettoliquidität	32,8	41,3	-20,6%

- **Ergebnis aus nicht-fortgeführten Aktivitäten** durch operatives Geschäft der MicroOptics und durch Transaktionskosten geprägt und damit auch wesentlicher Grund für geringeren **Jahresüberschuss**
- **Nettoliquidität** zum Jahresende verringerte sich u.a. aufgrund des weiteren Aufbaus von Vorräten

HGB-Abschluss 2023 und Gewinnverwendungsvorschlag

SÜSS MicroTec SE



- **Jahresüberschuss 2023:**
3.452 TEUR
- **Bilanzgewinn 2023:**
49.075 TEUR
- **Gewinnverwendungsvorschlag:**
 - Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,20 € je dividendenberechtigter Stückaktie
= 3.823 TEUR
 - Einstellung des Restbetrags in Höhe von 45.252 TEUR in die anderen Gewinnrücklagen

+ **Dividendenpolitik:** Unsere Aktionäre sollen über eine verlässliche und angemessene Ausschüttung am Unternehmenserfolg beteiligt werden; gleichzeitig soll das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel für das operative Geschäft und für strategische Investitionen verfügen und eine angemessene Eigenkapitalquote halten.

+ **Richtschnur:** Ausschüttung 20 bis 40 % des Konzern Free Cashflows
Konzern Free Cashflow 2023: -4,4 Mio. €
Konzern Free Cashflow 2023 (fortgeführte Aktivitäten): 7,9 Mio. €

+ Wir möchten unseren Aktionären eine stabile Dividende bieten und sie daher bereits jetzt in unserem Jubiläumsjahr am Erfolg des MicroOptics-Verkaufs partizipieren lassen.

Ausgewählte ESG-Indikatoren aus dem GB 2023

Relativer Energieverbrauch je Mio. € Umsatz gegenüber 2022 um 6% reduziert	Anteil erneuerbarer Energiequellen am Stromverbrauch: 49%	Wassereffizienz (in t Liter je Mio. € Umsatz) im Jahresvergleich um 26% erhöht
Fluktuationsrate im Jahresvergleich von 10,4% auf 9,5% gesenkt	Krankheitsquote der Mitarbeitenden von 6,8% auf 6,3% gesunken	Durchschnittsalter unserer Belegschaft: 42 Jahre
33 % Frauenanteil im Vorstand und 40 % Frauenanteil im Aufsichtsrat	Bestätigte Korruptions- oder Bestechungsfälle: 0 (Vorjahr: 0)	Durch Code of Conduct abgedecktes Einkaufsvolumen: 39% (Anstieg um 3 Prozentpunkte)

ESG ist wesentlicher und integrierter Teil unserer Unternehmensstrategie

Kern unserer Nachhaltigkeitsstrategie sind:

- die Klimaneutralität (Scope 1 und 2) bis 2030,
- die Entwicklung von SÜSS zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in der Halbleiterindustrie
- und die Etablierung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.

01

Unternehmen im Überblick

02

Entwicklung im Geschäftsjahr 2023

03

Ausblick 2024 und Entwicklung Q1-2024

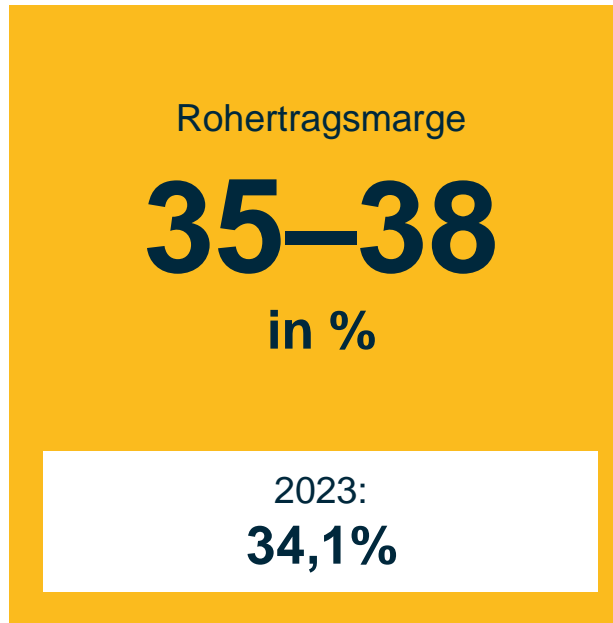
04

Strategie und Ambitionen 2030

Verbesserung der drei wesentlichen Steuerungsgrößen erwartet

Prognose 2024

Wir wollen unseren Zielen für das Jahr 2025 einen großen Schritt näher kommen, insbesondere in Bezug auf unsere Margen



Finanzergebnisse Q1-2024

98,3
in Mio. €

Auftragseingang
Q1-2024

93,5
in Mio. €

Umsatz
Q1-2024

39,1
in %

Bruttomarge
Q1-2024

15,9
in %

EBIT-Marge
Q1-2024

**Gesamtjahresprognose für alle drei wesentlichen
Finanzkennzahlen bestätigt**

Q1-2024: Umsatz-Rekordquartal und erfreuliche Margen

in Mio. €	Q1 2024	Q1 2023	Veränderung
Auftragseingang	98,3	94,9	3,6%
Auftragsbestand zum 31.03.	456,9	364,0	25,5%
Umsatz	93,5	64,0	46,1%
Bruttoergebnis vom Umsatz	36,6	22,0	66,4%
Bruttomarge	39,1%	34,4%	4,7%-Pkt.
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	14,9	3,8	292,1%
EBIT-Marge	15,9%	5,9%	10,0%-Pkt.
Periodenergebnis*	68,7	2,1	-
Ergebnis je Aktie (in €)*	3,59	0,11	-
Nettoliquidität*	102,4	42,5	140,9%
Free Cashflow*	70,7	0,3	-

- Anhaltend guter Auftragseingang und Rekordauftragsbestand bleiben Grundlage für weiteres Wachstum
- Bruttomarge und EBIT-Marge verbessert, insbesondere durch vorteilhaften Produktmix, insgesamt höheres Umsatzniveau und Effizienzsteigerungen in der Produktion trotz laufender Transformation
- Periodenergebnis enthält außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf des Segments MicroOptics (58,3 Mio. €)
- Nettoliquidität hat sich durch den Verkauf des MicroOptics-Geschäfts deutlich verbessert

*Q1-2024 enthält die Einnahmen aus der Veräußerung des Geschäftsbereichs MicroOptics

01

Unternehmen im Überblick

02

Entwicklung im Geschäftsjahr 2023

03

Ausblick 2024 und Entwicklung Q1-2024

04

Strategie und Ambitionen 2030

Unsere strategischen Stoßrichtungen

Strategische Initiativen



Erhöhung/Flexibilisierung der Fertigungskapazitäten

- + Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter in Hsinchu (Taiwan) zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für temporäre Bonder
- + Verstärkte Einbindung externer Produktionspartner zur Erhöhung und Flexibilisierung unserer Fertigung
- + Kontinuierliche Evaluierung eines möglichen Kaufs bzw. Neubaus einer zusätzlichen Produktionsstätte



Fokussierung des Produktportfolios aufs Kerngeschäft

- + Voller Fokus auf die Halbleiter-Equipment-Industrie durch die abgeschlossene Veräußerung des MicroOptics-Geschäfts
- + Konzentration auf Hochvolumenmärkte sorgt für reduziertes Produktangebot im Segment Advanced Backend Solutions



Innovationen

- + Hybrid Bonding-Portfolio um neue "Allrounder"-Lösung erweitert
- + GreenTrack als disruptive Lösung zur Reinigung von Wafern

Unsere strategischen Stoßrichtungen



**Erhöhung/Flexibilisierung
der Fertigungskapazitäten**



**Fokussierung des Produkt-
portfolios aufs Kerngeschäft**



Innovationen

Derzeit bauen wir in Taiwan Kapazitäten für temporäre Bonder auf



- Wir stellen mehr als 50 Mitarbeitende in Hsinchu ein, um die Produktionskapazitäten für temporäre Bonder auszubauen
- Erster temporärer Bonder “made in Taiwan” wurde Anfang März 2024 fertiggestellt
- Volle Kapazität wird im Laufe des dritten Quartals 2024 erwartet
- Nach Abschluss des Kapazitätsausbaus werden wir in Sternenfels und Hsinchu eine Fertigungskapazität für temporäre Bonder, Debonder und Cleaner im Wert von rund 150 Mio. € zur Verfügung haben



Unsere strategischen Stoßrichtungen



Erhöhung/Flexibilisierung der Fertigungskapazitäten



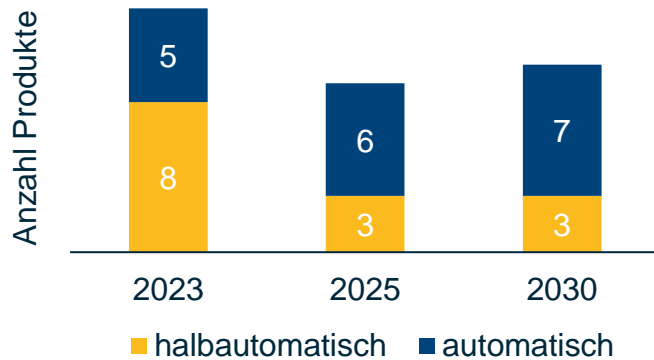
Fokussierung des Produktportfolios aufs Kerngeschäft



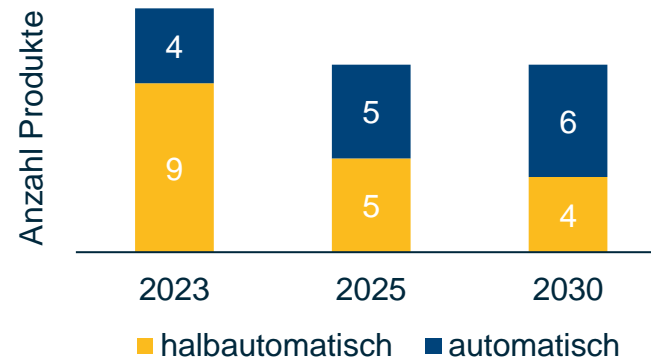
Innovationen

Wir fokussieren uns im Segment Advanced Backend Solutions auf Hochvolumenmärkte und reduzieren unser Angebot an halbautomatischen Anlagen

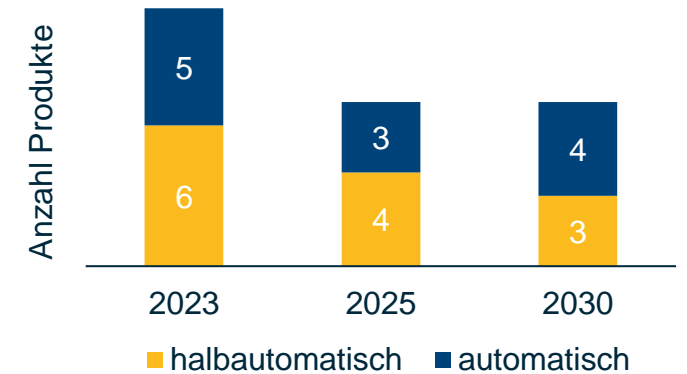
Bonding Systems



Coating Systems



Imaging Systems



Unsere strategischen Stoßrichtungen



Erhöhung/Flexibilisierung der Fertigungskapazitäten



Fokussierung des Produktportfolios aufs Kerngeschäft



Innovationen

Wir wollen unseren Kunden im Bereich Hybrid Bonding ein vollständiges Portfolio an Entwicklungs- und Produktionsanlagen anbieten

Wafer-to-Wafer HB XBS300 W2W

Produkt-Launch: 10/2022
Zielkunden: Hochvolumen-Produktion



Die-to-Wafer/Wafer-to-Wafer HB XBC300 Gen2 D2W/W2W

Produkt-Launch: 05/2024
Zielkunden: Forschungsinstitute, F&E-Einheiten der Hochvolumen-Produzenten



Die-to-Wafer HB XBC300 Gen2 D2W

Produkt-Launch: Q4/2024
Zielkunden: Hochvolumen-Produktion



Unsere strategischen Stoßrichtungen



Erhöhung/Flexibilisierung der Fertigungskapazitäten



Fokussierung des Produktportfolios aufs Kerngeschäft



Innovationen

Mit der umweltfreundlichen Reinigung von Wafern wollen wir einen neuen Markt erschließen



Problem: Bei der Reinigung von Wafern werden heute aggressive, umweltschädliche Chemikalien eingesetzt, die möglicherweise verboten bzw. stärker reguliert werden könnten.



Idee: Auf Basis unseres Knowhows in der Reinigung von Fotomasken und in der Prozessierung von Wafern entwickeln wir eine disruptive Lösung zur Wafer-Reinigung.



Vorteile für Kunden: umweltfreundlichere Reinigungslösung (ESG-Vorteil), optimierte Gesamtkosten des Prozesses (“Total Cost of Ownership”)

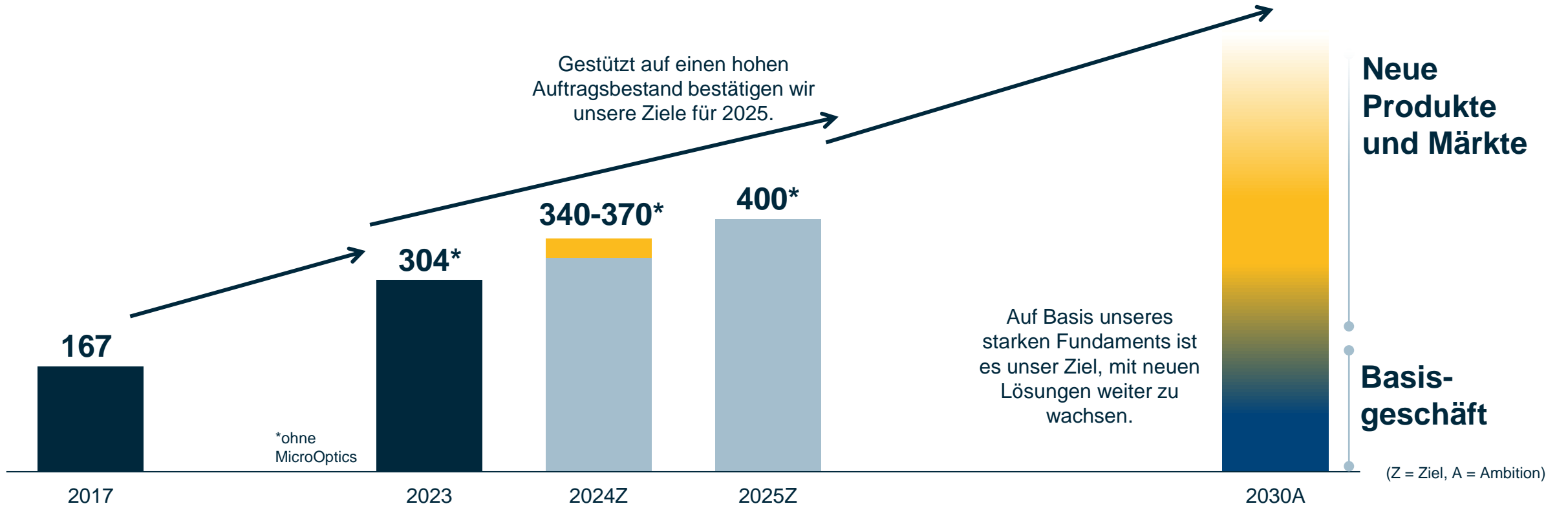


Projektstatus: Prototyp im Applikationszentrum Sternenfels installiert; erste Kundendemonstrationen mit vielversprechenden Ergebnissen durchgeführt



Prototyp GreenTrack

Unser Wachstumspfad bis 2025 und darüber hinaus



Wachstumstreiber 2023

- Umsetzung des hohen Auftragsbestands im Bereich Photomask Solutions und im Bonder-Geschäft in Umsatzwachstum

Wachstumstreiber 2024/2025

- Bonding (insbesondere im Hinblick auf die KI-basierte Nachfrage nach temporären Bonding-Lösungen)
- Photomask Solutions

Wachstumstreiber bis 2030

- Allgemeines erwartetes Marktwachstum in unseren Kerngeschäften (Lithografie, Bonding, Photomask)
- Hybrid Bonding
- Wafer Cleaning